

新たな可能性をプラスし、輝く未来へ。



2025年3月期 決算説明会 (2025年5月20日)

代表取締役 社長執行役員 小林 和也



本日の内容

1. 2025年3月期 連結決算の概要
2. 2026年3月期 連結業績予想
3. トピックス
4. 中期経営計画の進捗状況



1. 2025年3月期 連結決算の概要

2025年3月期連結決算 ハイライト



半導体分野の回復により、
過去最高の売上高を更新

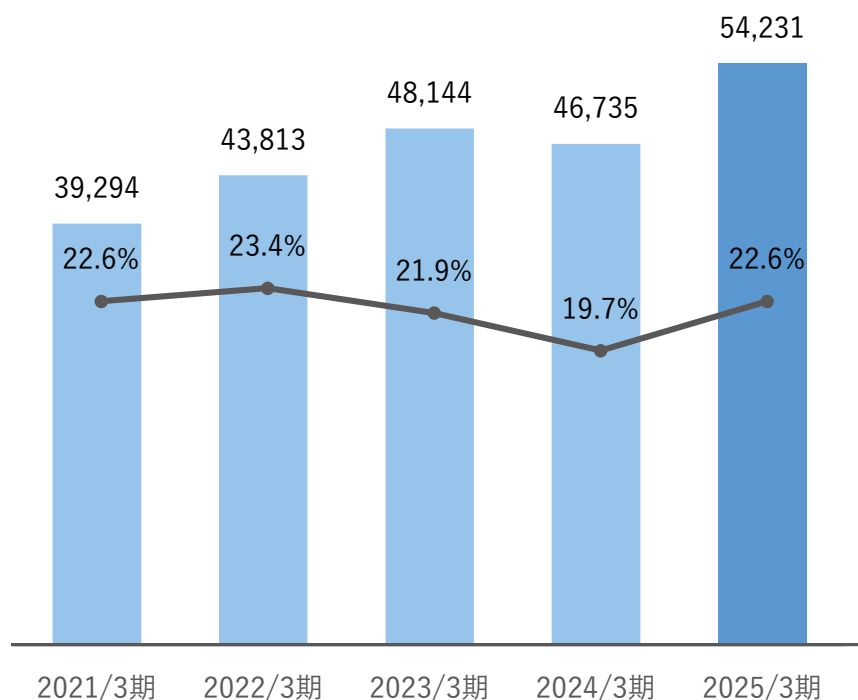


経常利益も2期前を上回り、
過去最高を更新

売上高

前期比
+16.0%

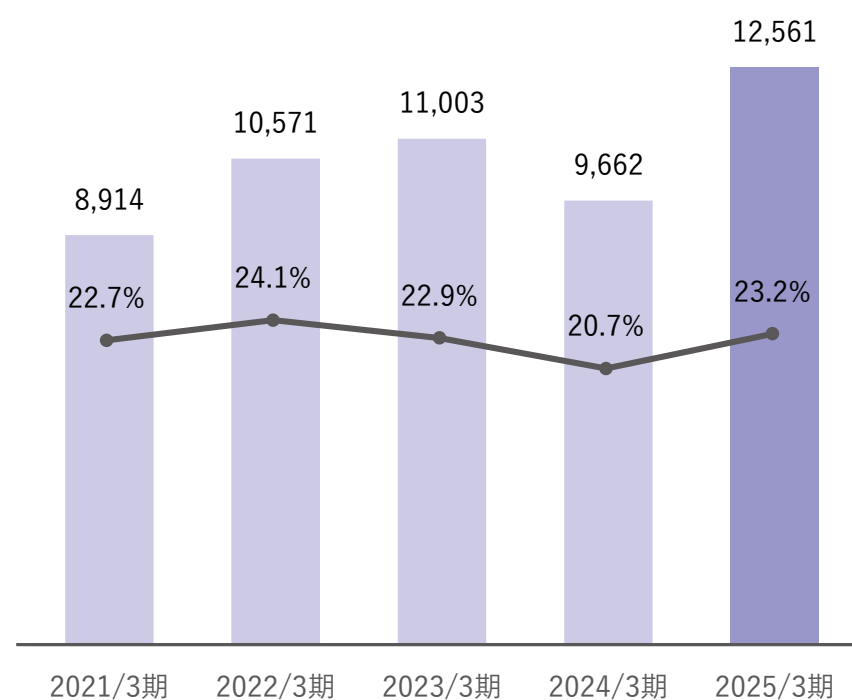
■ 売上高(百万円)
● 営業利益率



経常利益

前期比
+30.0%

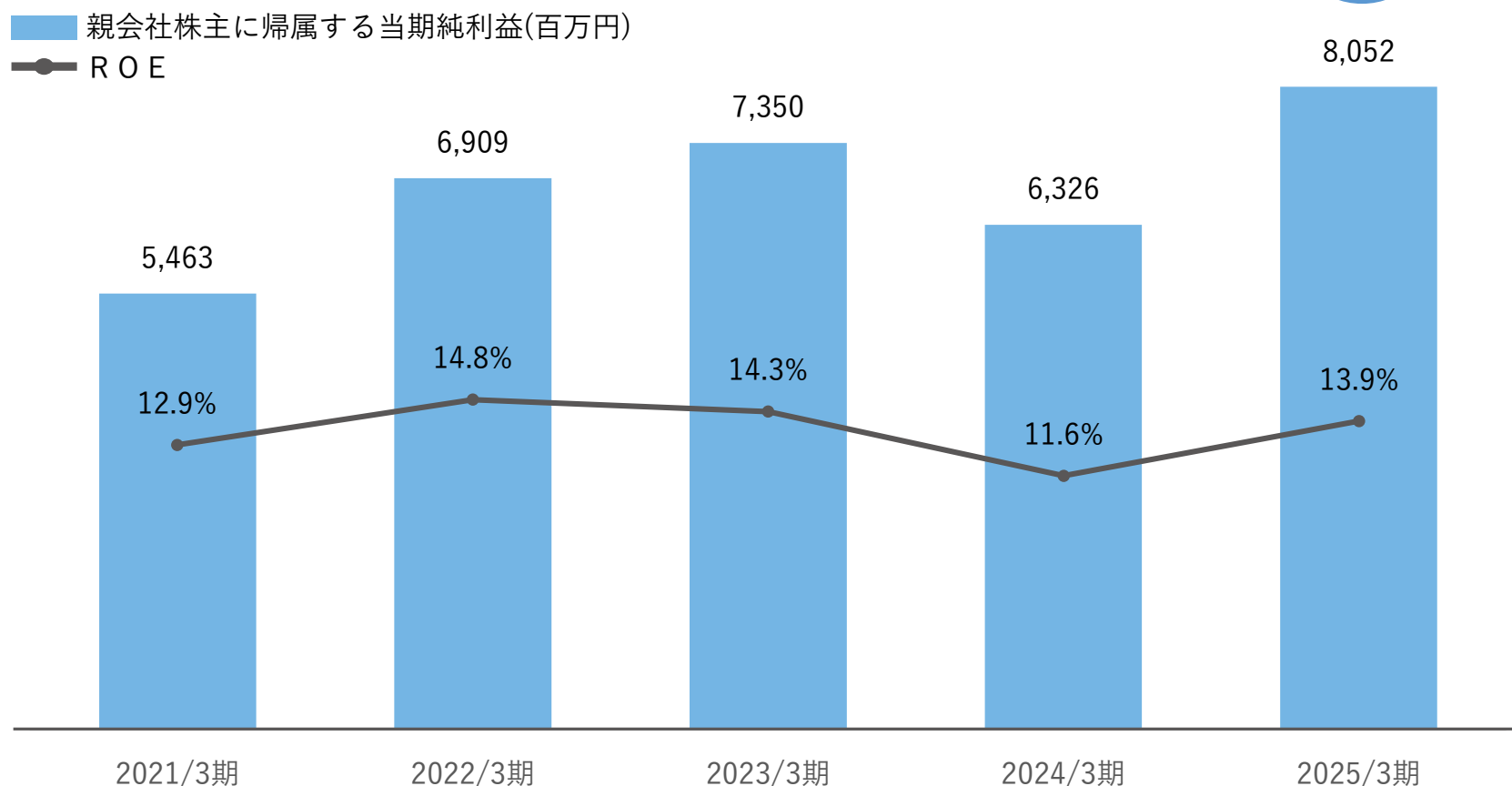
■ 経常利益(百万円)
● 経常利益率



2025年3月期連結決算

親会社株主に帰属する当期純利益と R O E

POINT 親会社株主に帰属する当期純利益は前期比27.3%増
R O E は13.9%に向上



2025年3月期 連結決算(P/L)の概要

- 半導体分野の受注増に伴い売上高は前期比16.0%増
- 経常利益は、利益率の高い半導体分野の売上増加により前期比30.0%増

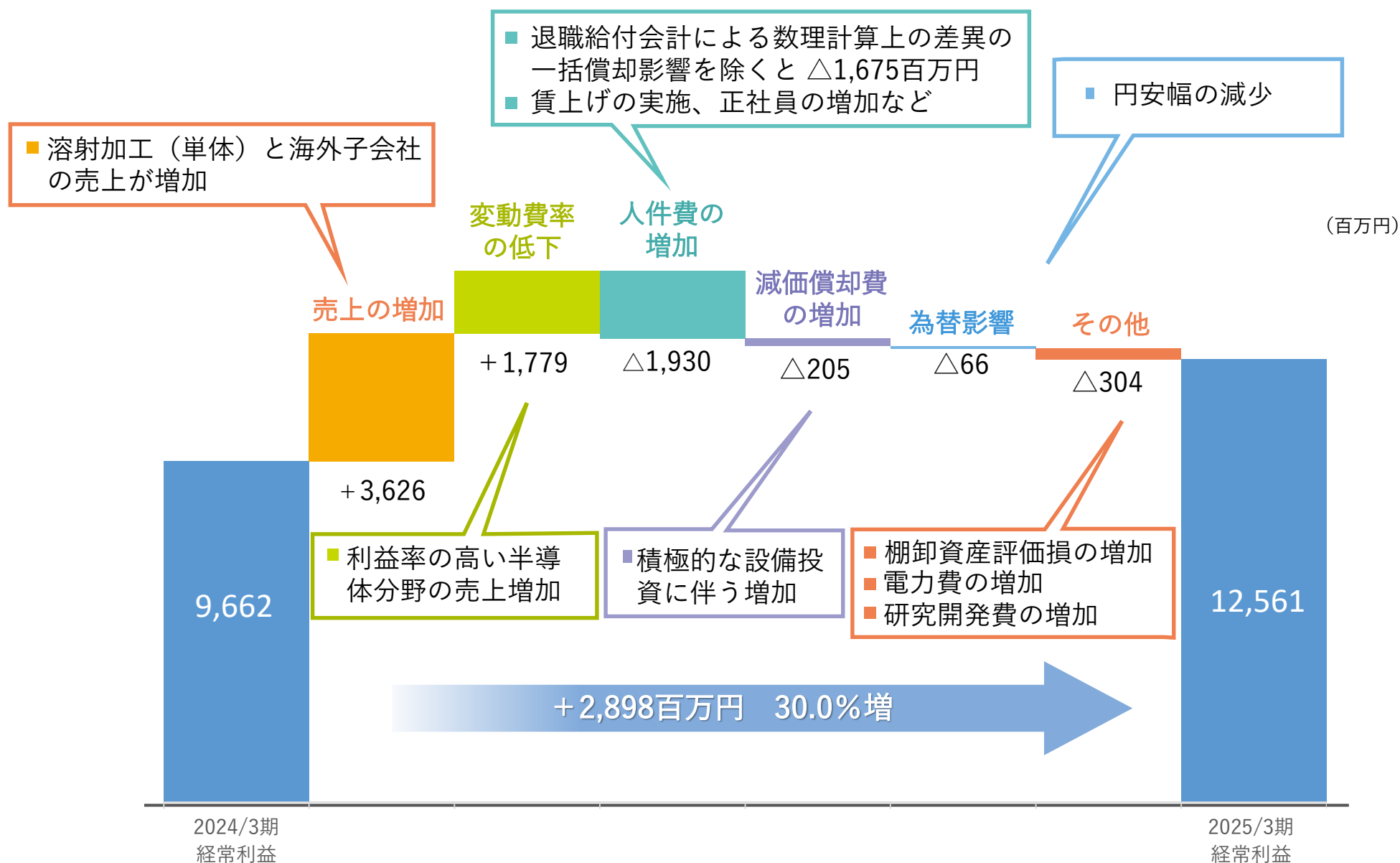
(百万円)	2024/3期		2025/3期		前年同期比増減	
	実 績	構成比	実 績	構成比	金 額	率
売上高	46,735	100.0%	54,231	100.0%	7,495	16.0%
営業利益	9,197	19.7%	12,271	22.6%	3,074	33.4%
経常利益	9,662	20.7%	12,561	23.2%	2,898	30.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	6,326	13.5%	8,052	14.8%	1,725	27.3%
1株当たり当期純利益 (EPS)	105.53円	—	135.45円	—	29.92円	—

2025年3月期 売上高（分野別）

- 最大セグメントの溶射加工（単体）が、売上高を牽引し前期比15.8%増加
- 海外子会社についても28.4%増と好調

(百万円)	2024/3期		2025/3期		前年同期比増減	
	実 績	構成比	実 績	構成比	金 額	率
売上高	46,735	100.0%	54,231	100.0%	7,495	16.0%
■ 溶射加工(単体)	33,859	72.4%	39,213	72.3%	5,354	15.8%
半導体・F P D	19,557	41.8%	24,114	44.5%	4,557	23.3%
産業機械	4,923	10.5%	4,872	9.0%	△51	-1.0%
鉄鋼	3,651	7.8%	3,927	7.2%	276	7.6%
その他	5,727	12.3%	6,298	11.6%	571	10.0%
■ その他表面処理加工	3,019	6.5%	2,880	5.3%	△138	-4.6%
■ 国内子会社	2,457	5.3%	2,656	4.9%	198	8.1%
■ 海外子会社	7,257	15.5%	9,319	17.2%	2,061	28.4%
受取ロイヤリティー等	141	0.3%	161	0.3%	19	13.7%

経常利益 増減要因分析



2025年3月期連結決算 セグメント別

TOCALO

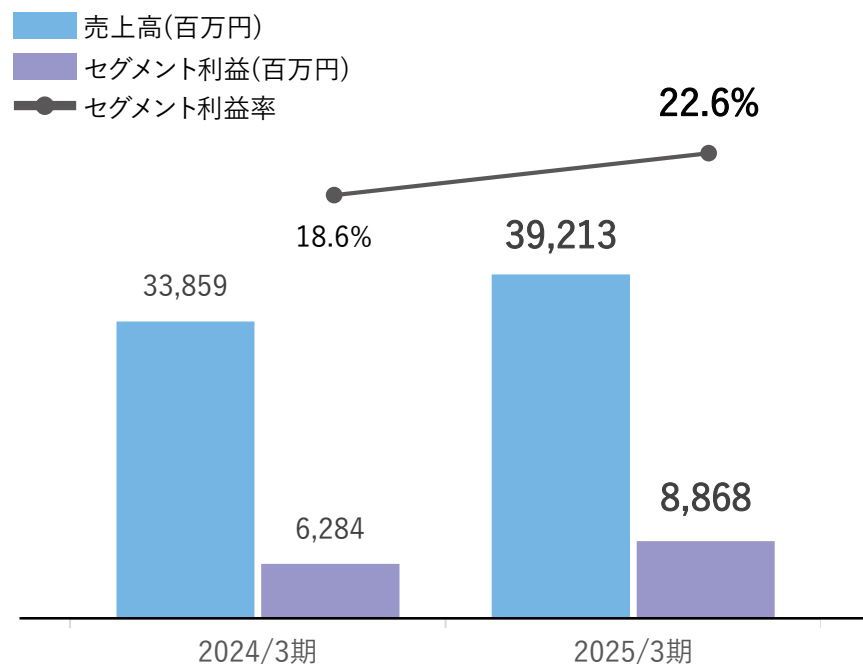
溶射加工(単体)

半導体分野の回復をはじめ、鉄鋼分野、その他分野も好調に推移し、増収増益

前年同期比増減率

売上高 …………… +15.8%

セグメント利益 … +41.1%



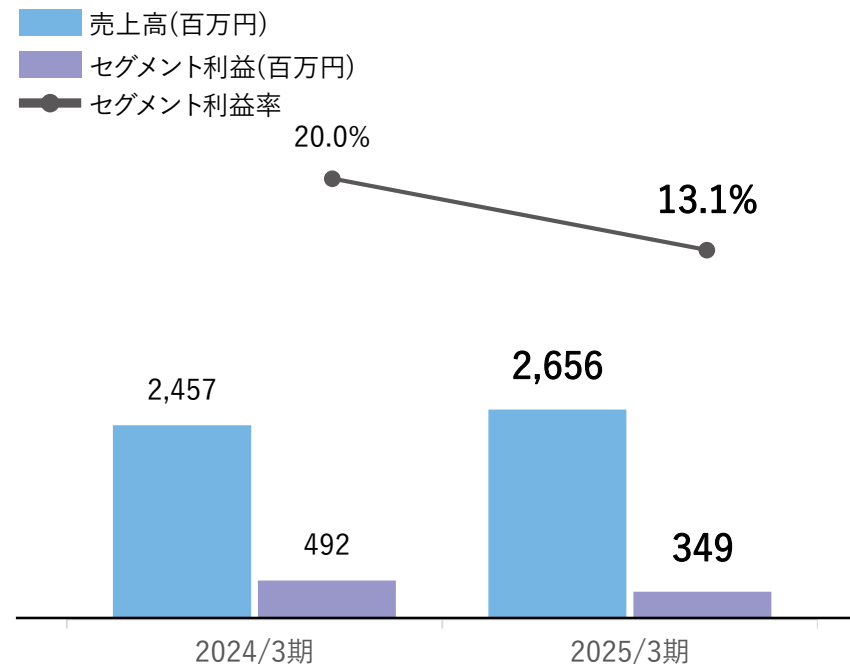
国内子会社

寺田工作所を連結に加え増収となるも、日本コーティングセンターの切削工具が伸び悩み減益

前年同期比増減率

売上高 …………… +8.1%

セグメント利益 … -29.1%



2025年3月期連結決算 セグメント別

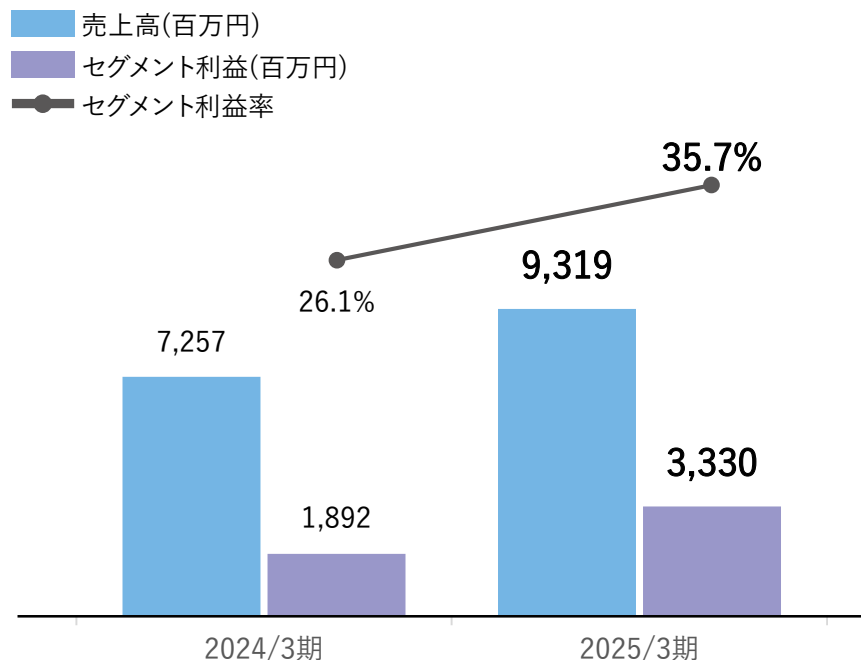
海外子会社

半導体および鉄鋼分野の売上伸長により、増収増益

前年同期比増減率

売上高 …………… +28.4%

セグメント利益 … +76.0%



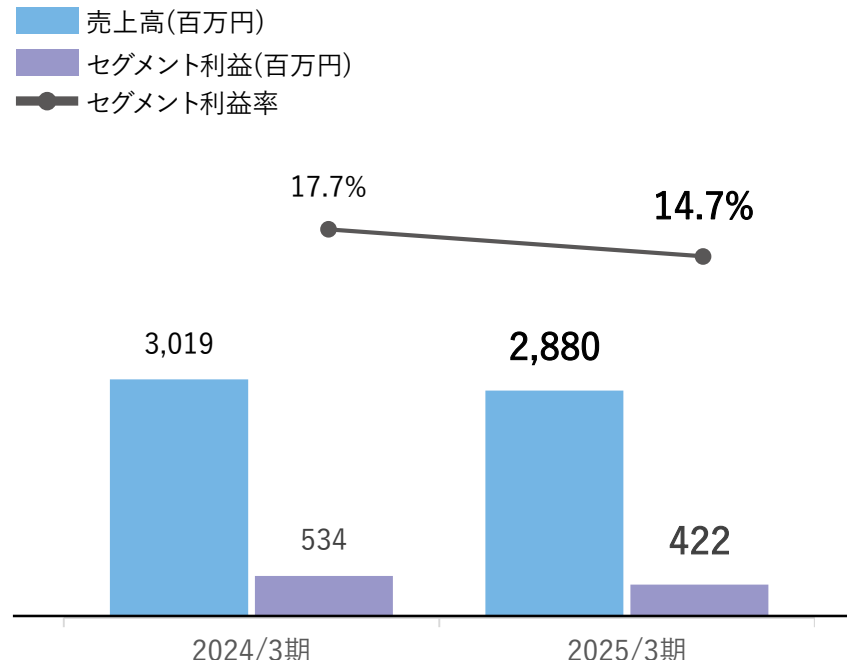
その他表面処理加工

農業機械部品向けの受注が在庫調整に入り、減収減益

前年同期比増減率

売上高 …………… -4.6%

セグメント利益 … -21.0%



セグメント情報

(百万円)					前年同期比増減			
	2024/3期		2025/3期		売上高		セグメント利益	
	売上高	セグメント利益	売上高	セグメント利益	金 額	率	金 額	率
■ 溶射加工(単体)	33,859	6,284	39,213	8,868	5,354	15.8%	2,583	41.1%
■ 国内子会社	2,457	492	2,656	349	198	8.1%	△143	-29.1%
■ 海外子会社	7,257	1,892	9,319	3,330	2,061	28.4%	1,438	76.0%
■ その他表面処理加工	3,019	534	2,880	422	△138	-4.6%	△112	-21.0%
合 計	46,593	9,204	54,069	12,970	7,476	16.0%	3,765	40.9%

(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

財政状態

- 総資産は、前期末比37億円の増加（有形固定資産の増加23億円）
- 自己資本比率は、前期末比3.1ポイント上昇の74.3%
- 有利子負債は、前期末比12億円の減少

(百万円)	2024/3期	2025/3期
	4Q末	4Q末
総資産	77,940	81,676
自己資本	55,460	60,646
自己資本比率	71.2%	74.3%
有利子負債残高	5,002	3,796

キャッシュ・フローの状況

- 当期のフリーキャッシュ・フロー（営業C F + 投資C F）は+28億円
- 投資C F／有形固定資産の取得 前期：△47億円 当期：△55億円
- 財務C F／配当金の支払額 前期：△31億円 当期：△34億円
自己株式の取得 前期：△20億円 当期：－

(百万円)	2024/3期 通期	2025/3期 通期
営業キャッシュ・フロー	7,877	9,077
投資キャッシュ・フロー	△ 4,634	△ 6,194
財務キャッシュ・フロー	△ 3,241	△ 5,124
現金及び現金同等物の期末残高	19,656	17,591

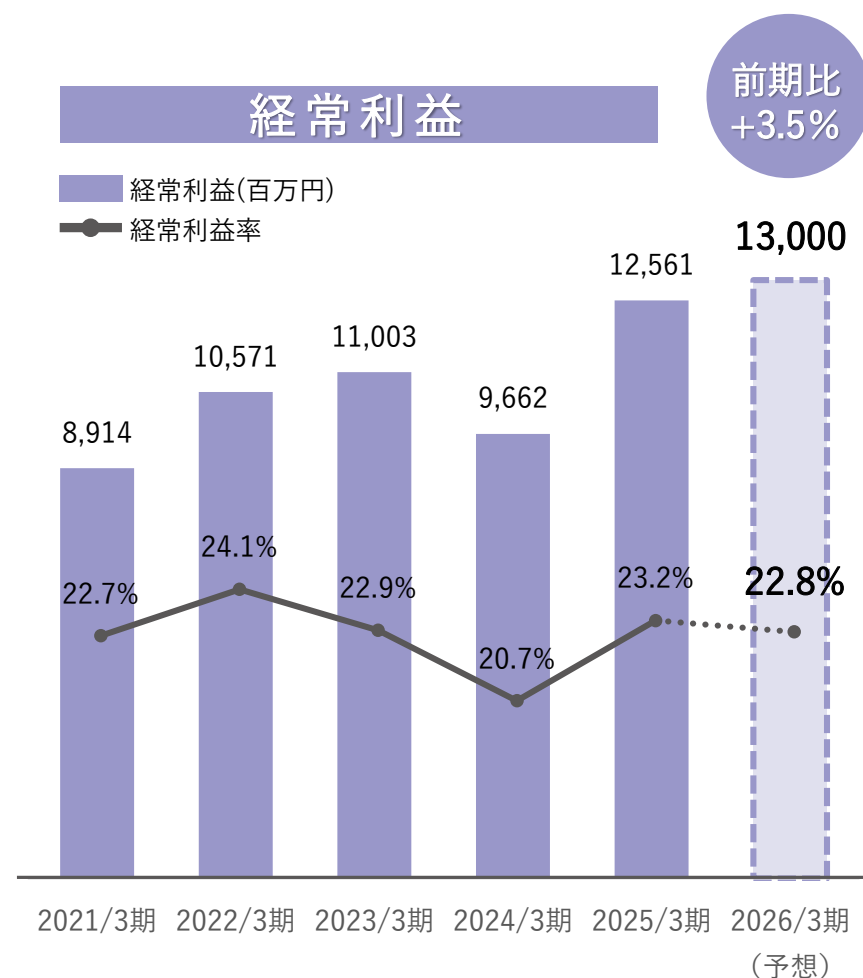
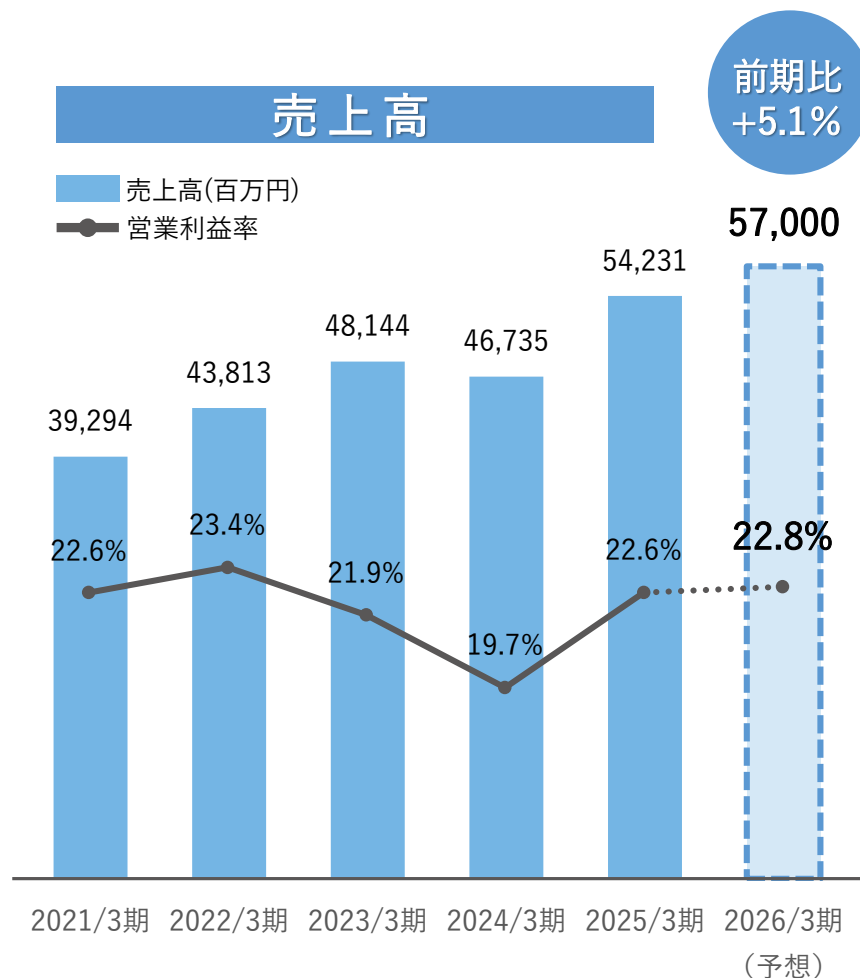


2. 2026年3月期 連結業績予想

売上高と経常利益の見通し

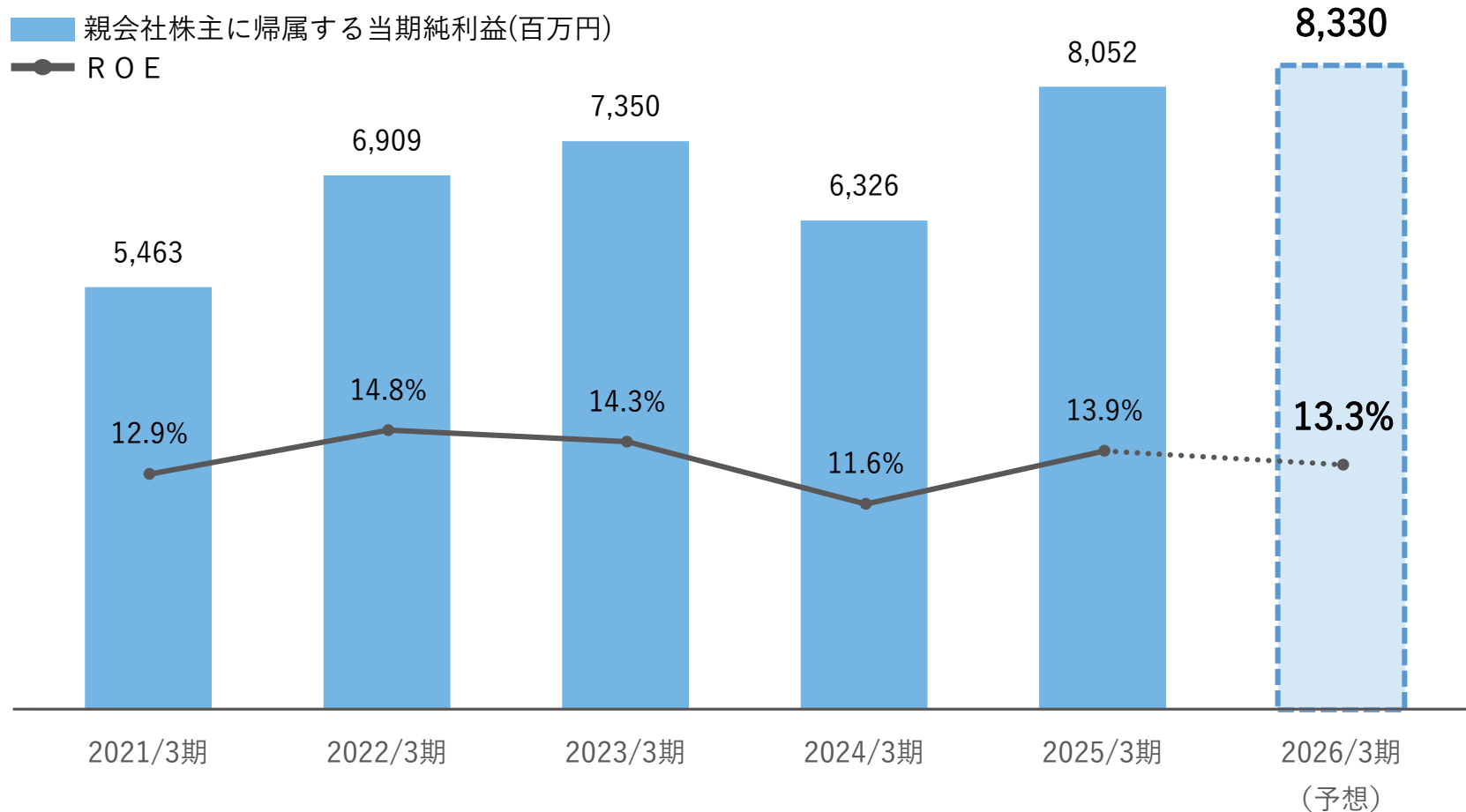
POINT 半導体分野が引き続き好調に推移し、過去最高の売上高となる見通し

POINT 増収に伴い、経常利益も過去最高益を更新する見通し



親会社株主に帰属する当期純利益と R O E の見通し

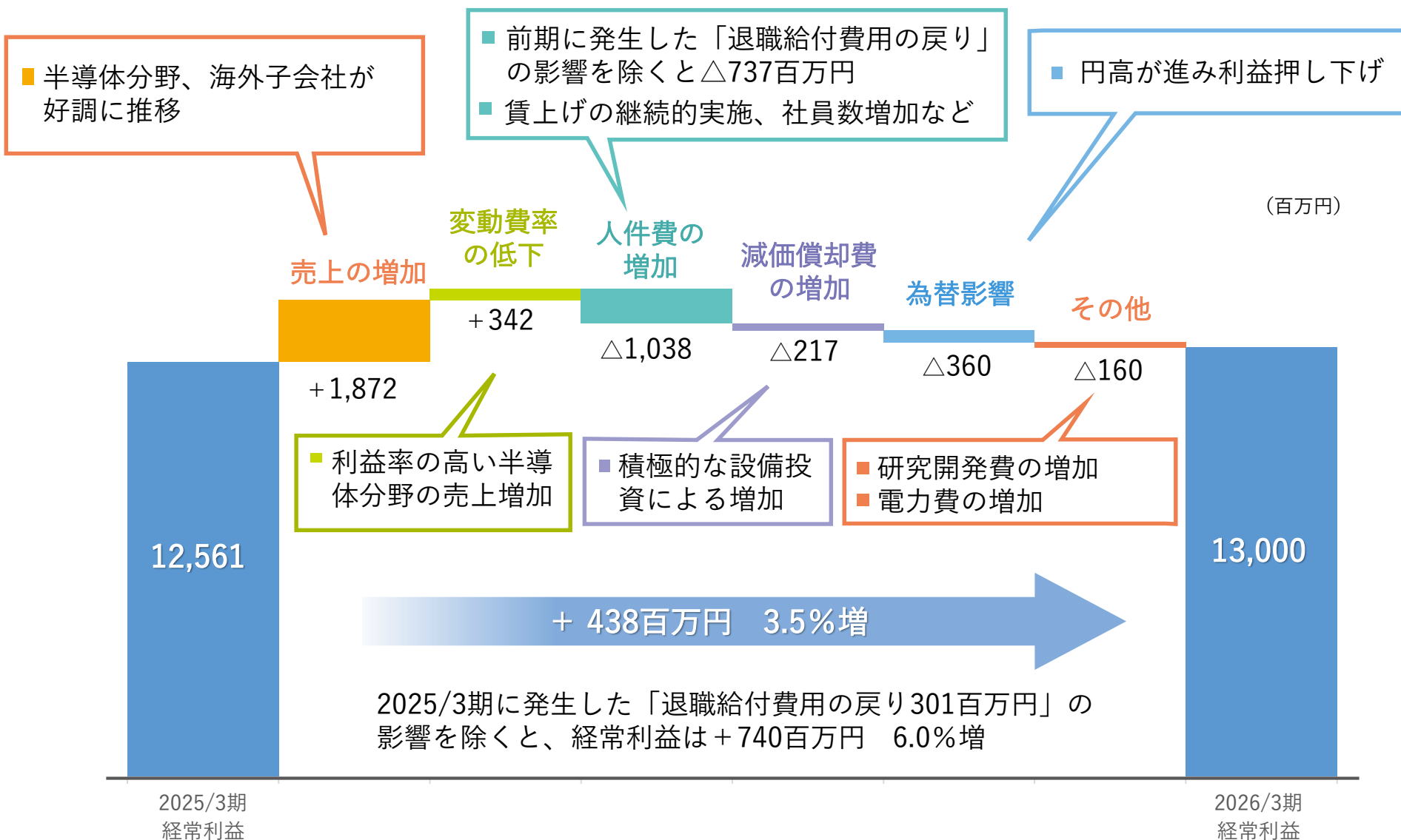
POINT 親会社株主に帰属する当期純利益は前期比3.4%増
R O E は13.3%とほぼ横ばい



2026年3月期 連結業績予想

(百万円)	2025/3期 通期		2026/3期 通期		前期実績比増減	
	実 績	構成比	予 想	構成比	金額	率
売上高	54,231	100.0%	57,000	100.0%	2,768	5.1%
■ 溶射加工(単体)	39,213	72.3%	39,265	68.9%	51	0.1%
半導体・F P D	24,114	44.5%	25,187	44.2%	1,072	4.4%
産業機械	4,872	9.0%	4,338	7.6%	△534	-11.0%
鉄鋼	3,927	7.2%	4,110	7.2%	182	4.6%
その他	6,298	11.6%	5,630	9.9%	△668	-10.6%
■ その他表面処理加工	2,880	5.3%	2,474	4.3%	△406	-14.1%
■ 国内子会社	2,656	4.9%	3,088	5.4%	431	16.3%
■ 海外子会社	9,319	17.2%	12,013	21.1%	2,693	28.9%
受取ロイヤリティー等	161	0.3%	160	0.3%	△1	-0.8%
営業利益	12,271	22.6%	13,000	22.8%	728	5.9%
経常利益	12,561	23.2%	13,000	22.8%	438	3.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	8,052	14.8%	8,330	14.6%	277	3.4%
1株当たり当期純利益 (EPS)	135.45円	—	140.11円	—	4.66円	—
自己資本利益率 (ROE)	13.9%	—	13.3%	—	-0.6pt	—

連結業績予想 経常利益 増減要因分析



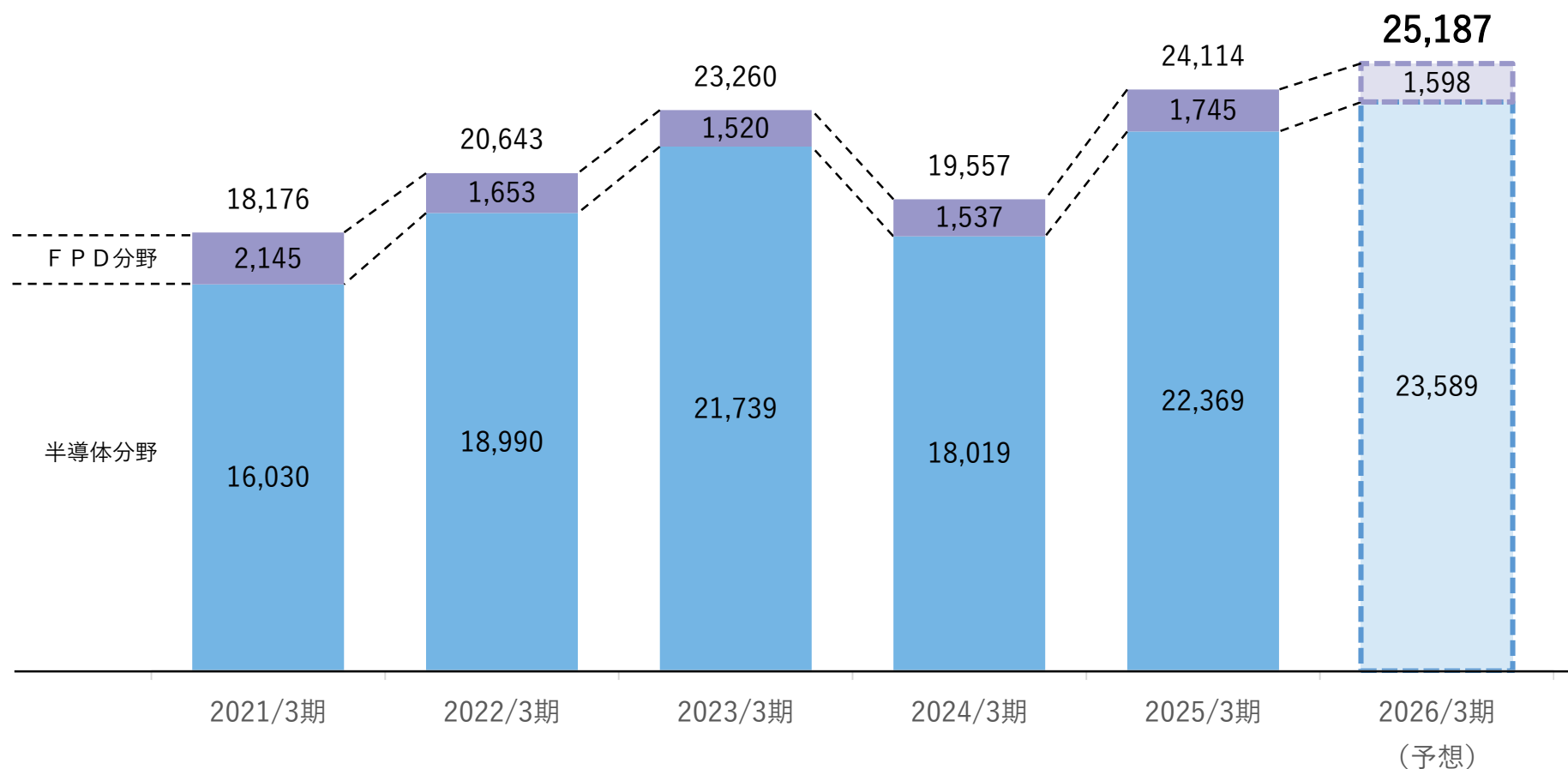
半導体・F P D分野の売上推移



半導体分野は今期も高水準の需要が継続し、好調に推移する見通し

前期比
+4.4%

(百万円)



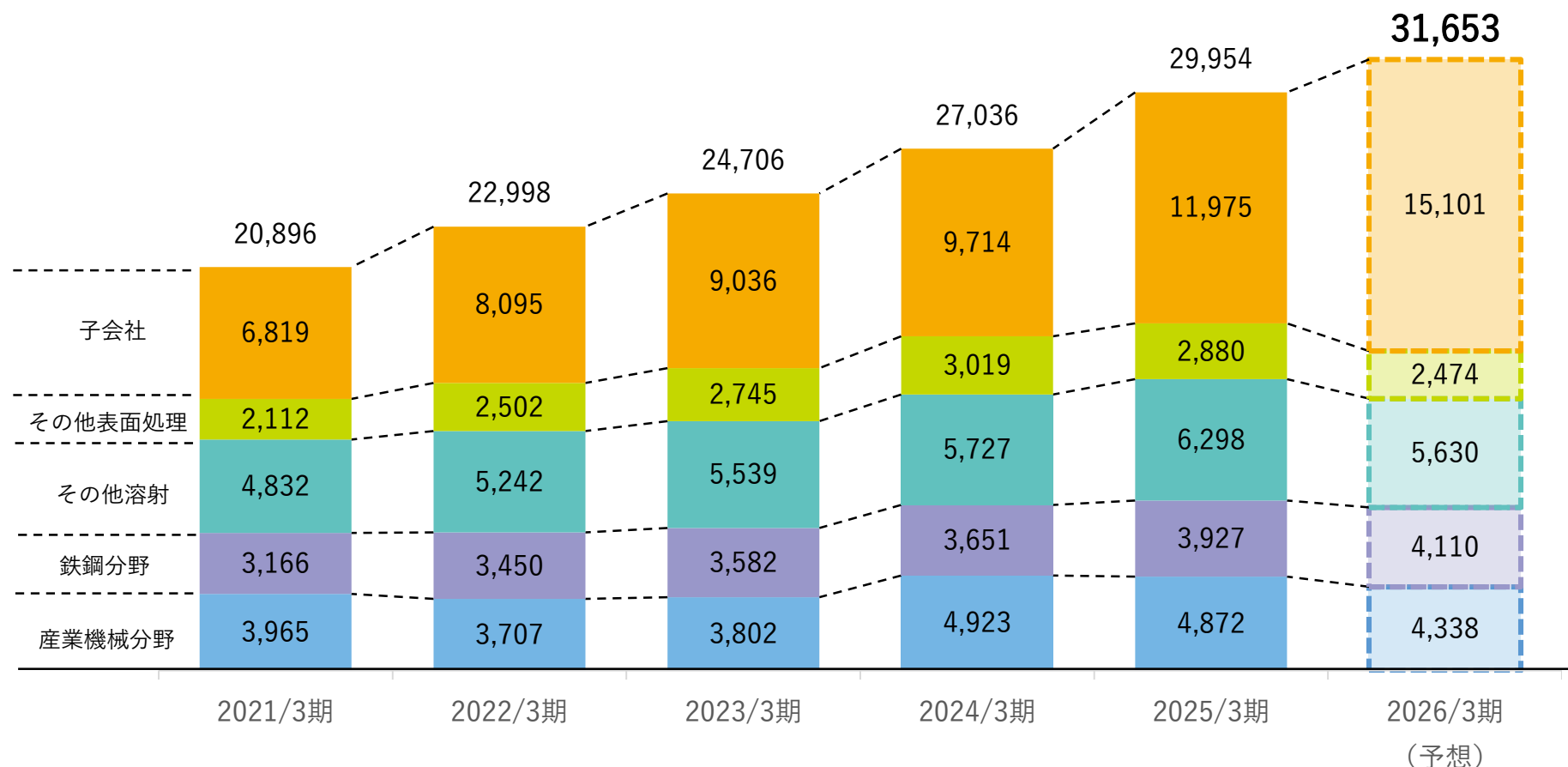
半導体・F P D分野以外の売上推移



半導体・F P D分野以外の売上高は、前期比5.7%増を見込む
子会社も引き続き好調に推移する見通し

前期比
+5.7%

(百万円)



(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

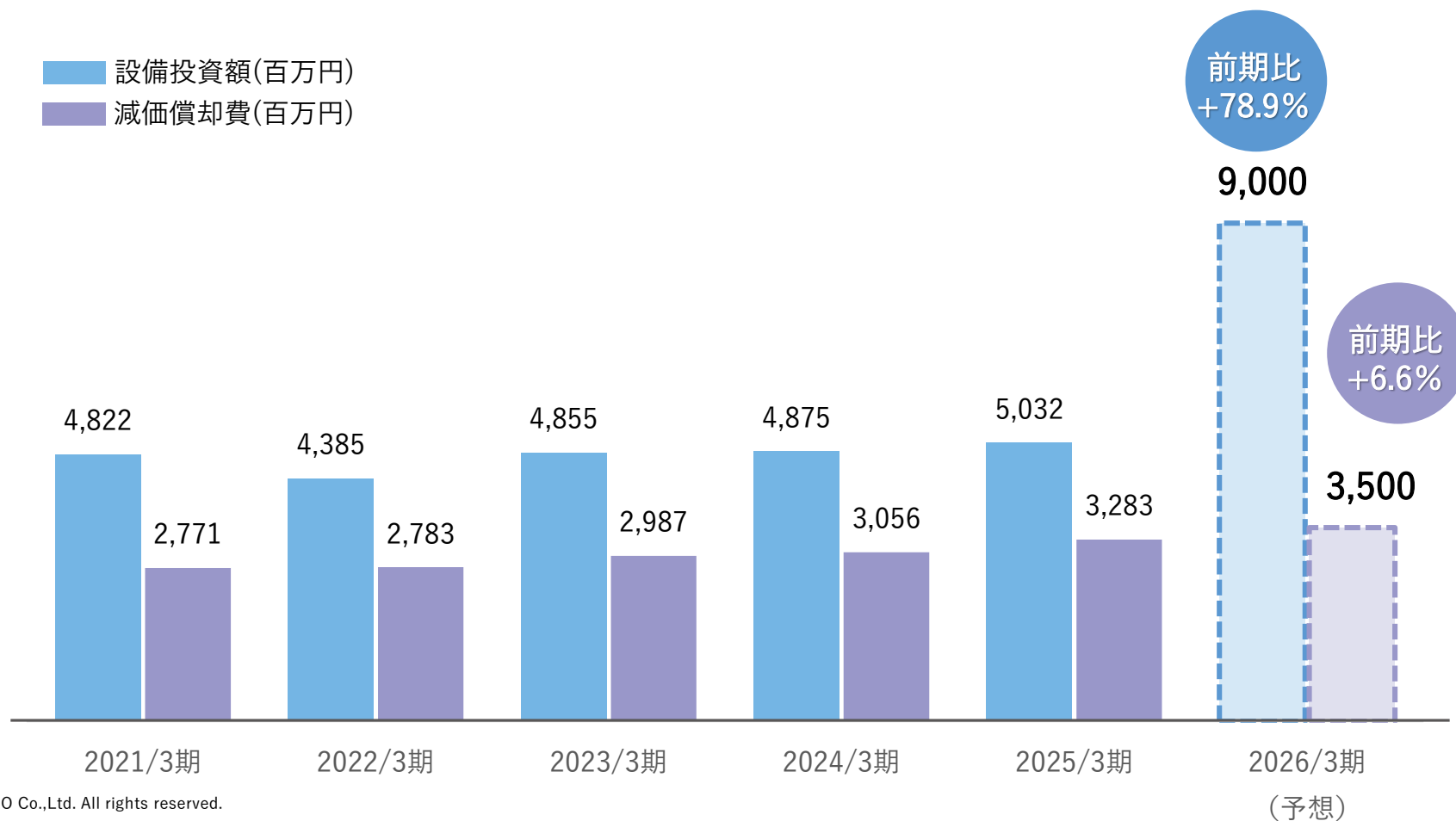
設備投資額と減価償却費

POINT

2026年3月期の設備投資予定額 90億円

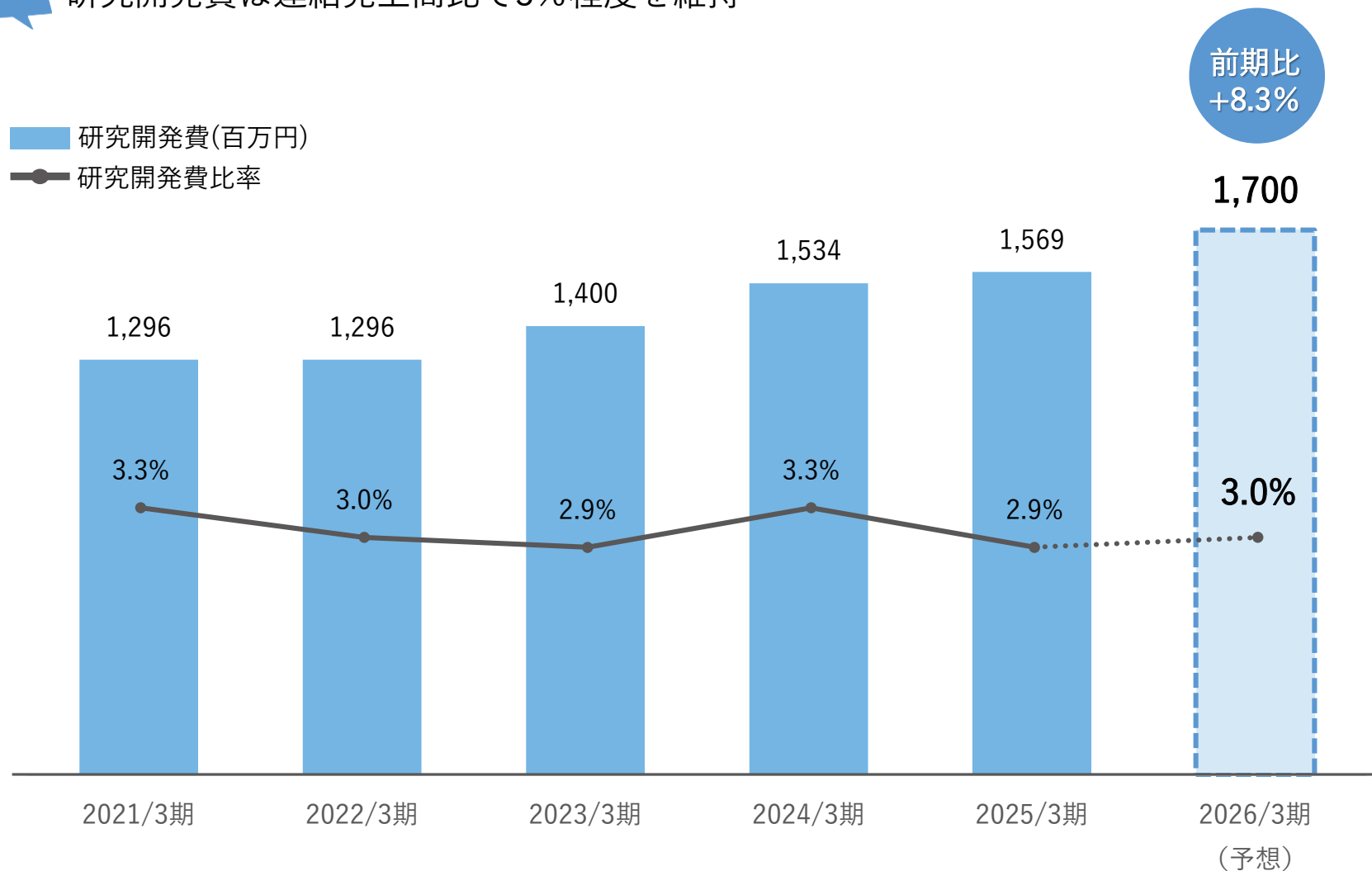
- トーカロ 70億円：東京・北九州工場新棟建設、増産対応・生産効率化、研究設備など
- 国内子会社 8億円：寺田工作所の新棟建設、日本コーティングセンターの生産能力増強など
- 海外子会社 12億円：東賀隆（昆山）・漢泰国際電子（台湾）での新工場立ち上げなど

■ 設備投資額(百万円)
■ 減価償却費(百万円)



研究開発費

POINT 研究開発費は連結売上高比で3%程度を維持



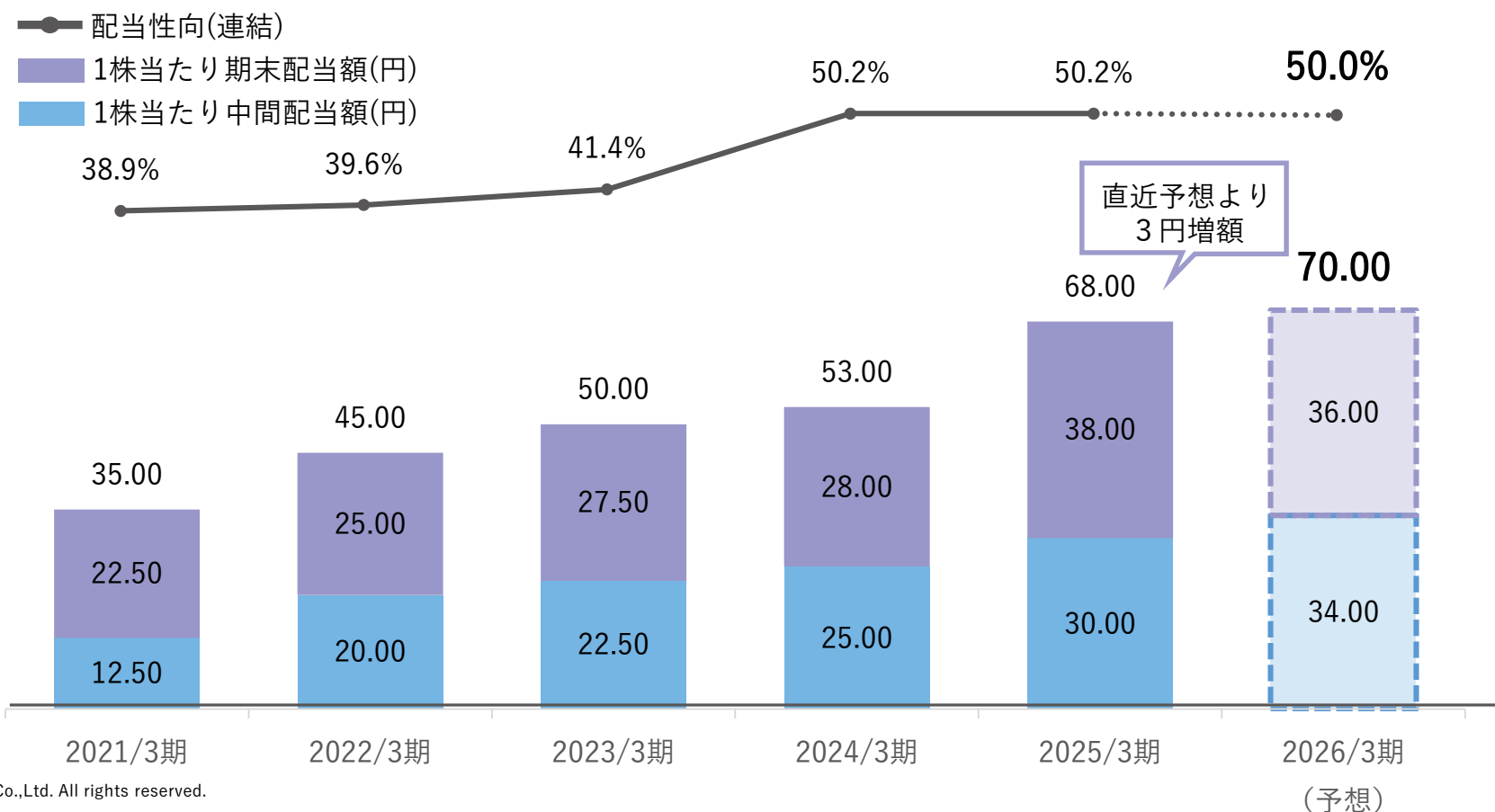
1株当たり配当額と配当性向の推移

POINT

2026年3月期の年間配当は増収により、70円に増配を予定

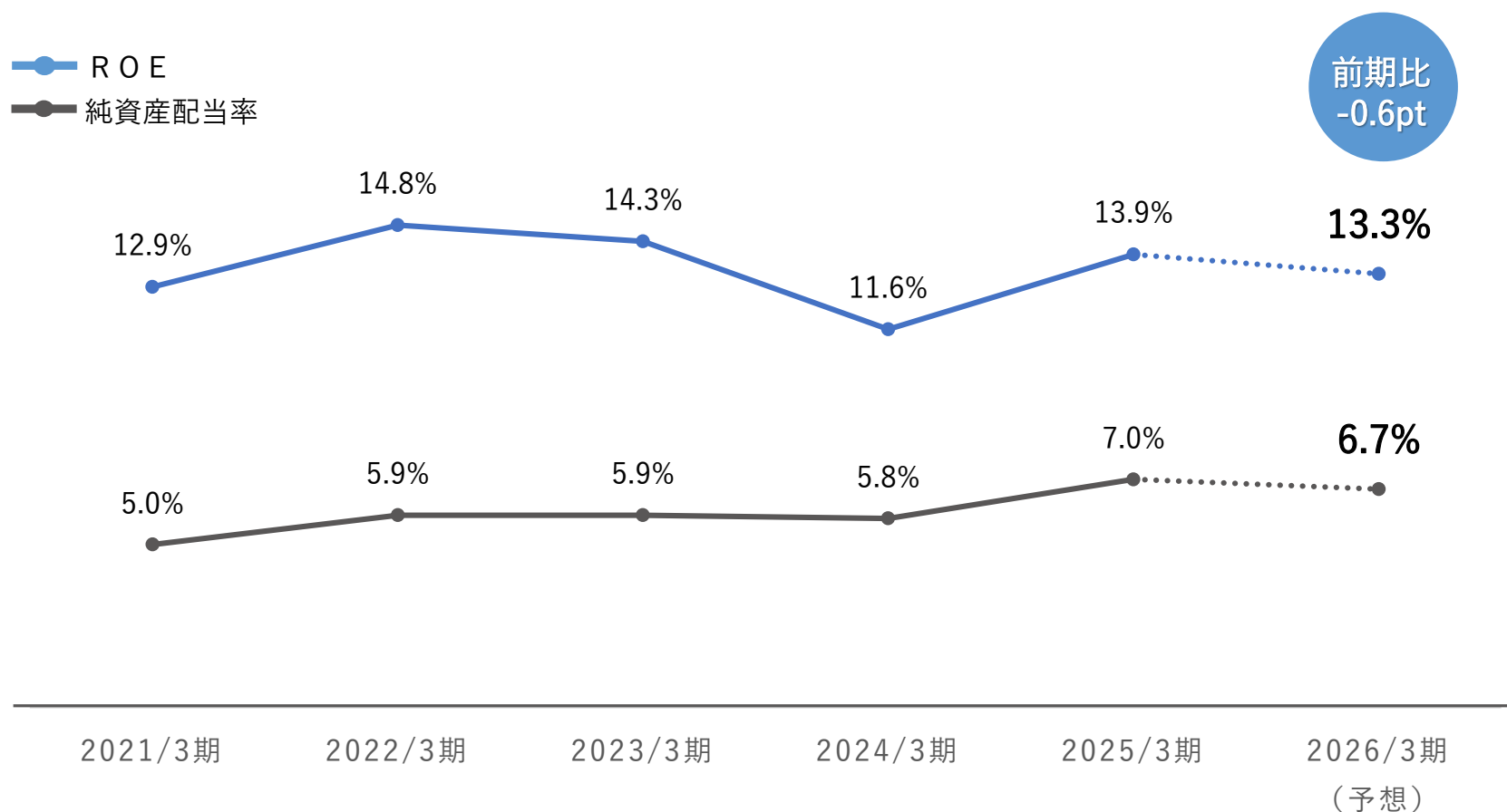
株主還元方針

- 連結配当性向 50%程度および純資産配当率（D O E）5%以上を目標とする
- 自己株式の取得も、事業環境や財務状況などを考慮しつつ機動的に実施



R O E と D O E の推移

POINT R O E ※は13.3%と若干低下するものの、D O E ※は6.7%と目標とする5%を上回る見込み



※ R O E (自己資本利益率) = 当期純利益 / 期中平均自己資本

※ D O E (純資産配当率) = 1株当たり配当金 / 期中平均1株当たり純資産 (= R O E × 配当性向)



3.トピックス

- ① 東京エレクトロン株式会社「環境パートナー賞」を受賞
- ② 持続可能な社会に貢献するサプライチェーンの構築
- ③ 安全衛生への取り組み
- ④ 今後の成長を支える工場棟の建設
- ⑤ 経済産業省による成長投資補助金の採択決定

① 東京エレクトロン株式会社「環境パートナー賞」を受賞

東京エレクトロン株式会社様主催の「TELパートナーズデイ」において、「環境パートナー賞」を受賞いたしました。



受賞理由：

部品製造工程で排出されるCO₂を削減する当社の技術が、東京エレクトロン様の目指すネットゼロへの取り組みに大きく貢献するものと評価され、全パートナー企業の中から選ばれた4社のうちの1社として受賞いたしました。

当社は今後もお客様の信頼できるパートナーとして、これまで以上に革新的な技術開発に挑戦し、新たな価値を創出してまいります。

② 持続可能な社会に貢献するサプライチェーンの構築

✦ 「お取引先様御礼の会」 開催

開催目的：お取引先様への感謝と関係強化

実施拠点：全事業所にて実施

参加企業数：合計95社



「サステナブル調達ガイドライン」
を策定（2024年8月）

ガイドラインの内容

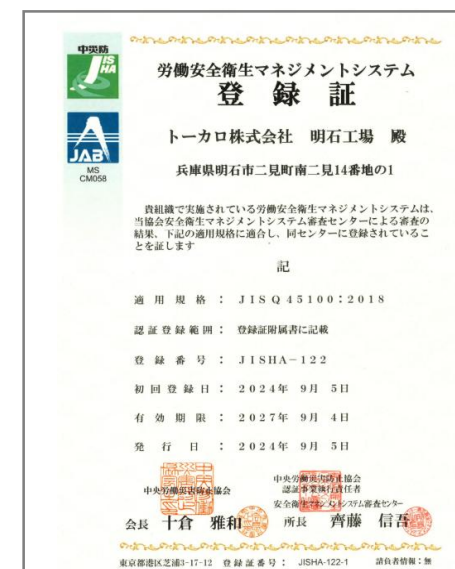
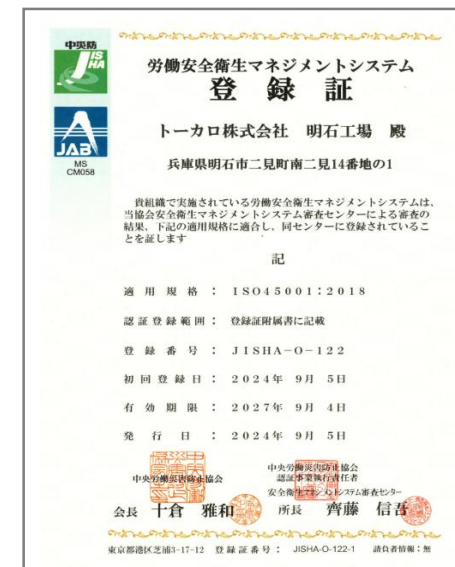
1. 法令順守と国際規範の尊重
2. 人権・労働
3. 安全衛生
4. 環境
5. 公正取引・倫理
6. 安全性・品質
7. 情報セキュリティ
8. 事業継続計画

③ 安全衛生への取り組み

ISO 45001/JIS Q 45100の認証を全事業所で取得

労働安全衛生マネジメントシステムである
国際規格「ISO 45001」
日本産業規格「JIS Q 45100」
の認証を全事業所において取得しました。

我々は「安全はすべてに優先する」を安全衛生管理の基本とし、すべての従業員の安全と健康のために、人にやさしい職場づくりに取り組みます。



④ 今後の成長を支える工場棟の建設



2025年5月 神戸第2工場竣工

用途・目的：半導体・医療分野などの新規受注、増産、生産効率化
 所在地：神戸市西区見津が丘1丁目16番5
 工場概要：3階建、延床面積3,120㎡（建築面積1,270㎡）
 建設費用：約13億円 ※生産設備は含みません。



2025年7月 北九州工場 新棟の着工（予定）

用途・目的：半導体製造装置部品向け表面処理加工の生産能力強化
 所在地：福岡県京都郡苅田町鳥越町10-8、10-9
 建築面積：約1,984㎡ 延床面積：約6,994㎡
 建設費用：約32億円 ※生産設備は含みません。
 操業開始：2027年5月（予定）



2025年8月 東京工場行田事業所 新棟の着工（予定）

用途・目的：半導体製造装置部品向け表面処理加工の生産能力強化
 所在地：千葉県船橋市豊富町631番13
 建築面積：約3,734㎡ 延床面積：約14,201㎡
 建設費用：約67億円 ※生産設備は含みません。
 操業開始：2027年末（予定）

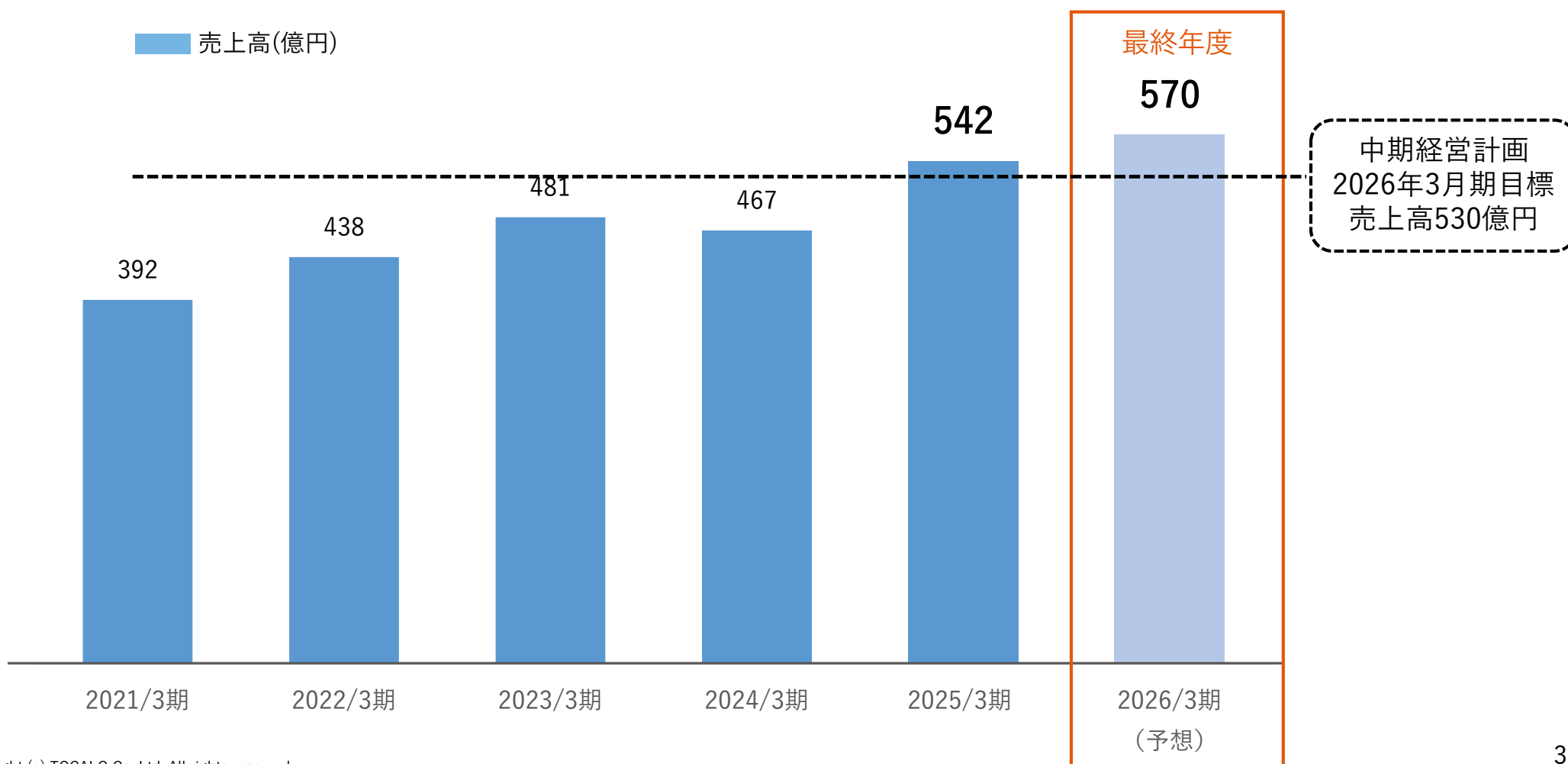


4.中期経営計画の進捗状況

中期経営計画（売上高）の進捗状況



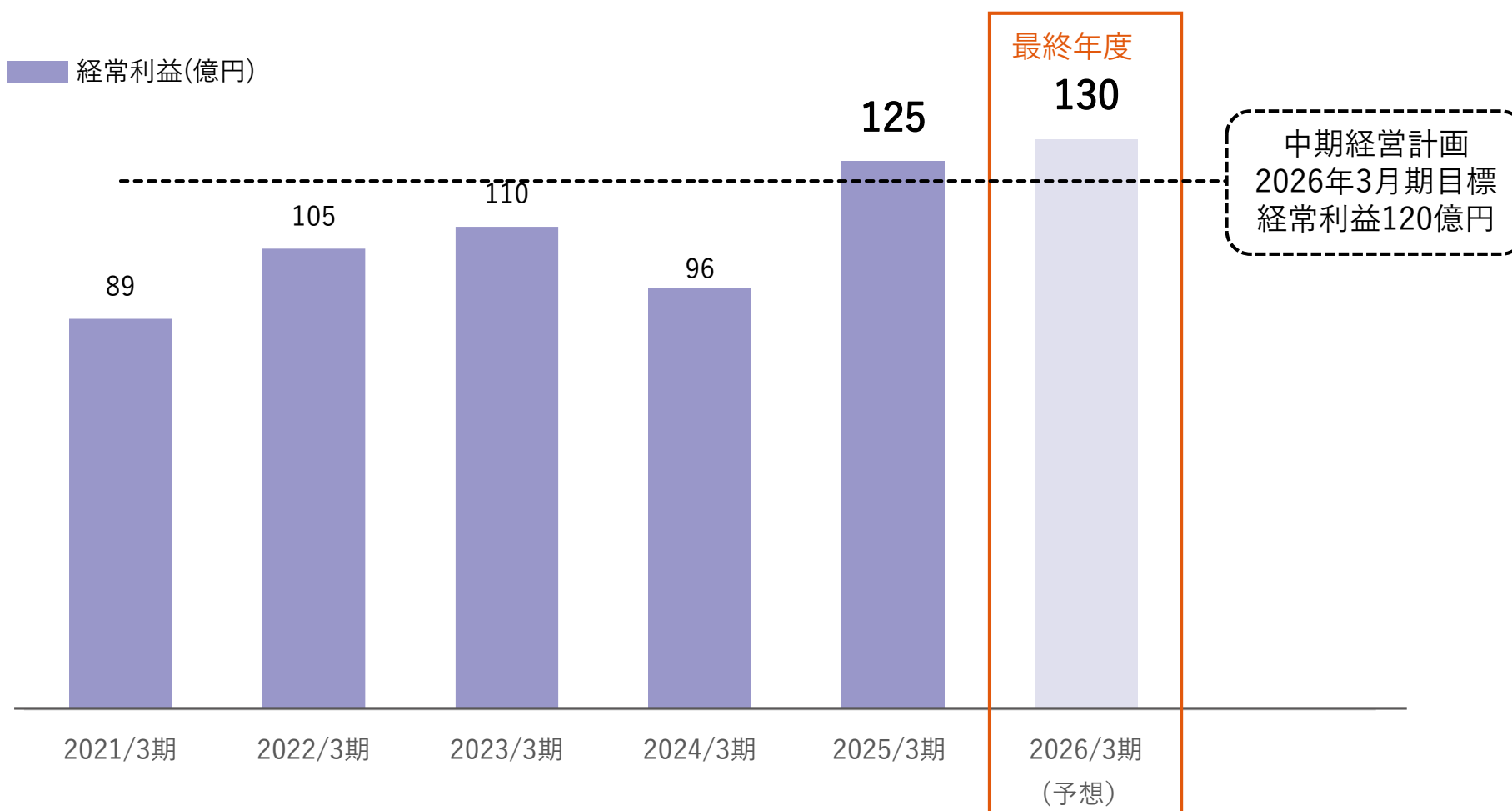
売上高は計画の530億を1年前倒しで達成、
最終年度である2026年3月期の業績予想は570億円の過去最高を更新する計画



中期経営計画（経常利益）の進捗状況



2026年3月期の経常利益も計画に対して1年前倒しで達成
最終年度である2026年3月期の予想は130億円の過去最高を更新する計画



中期経営計画策定に向けて (2030年に向けた売上成長イメージ)

外部環境

- 半導体市場は、2030年に向けて約2倍に拡大する
- 顧客（製造業）のニーズとして、環境負荷低減や省エネなどへの対応の重要性が高まる

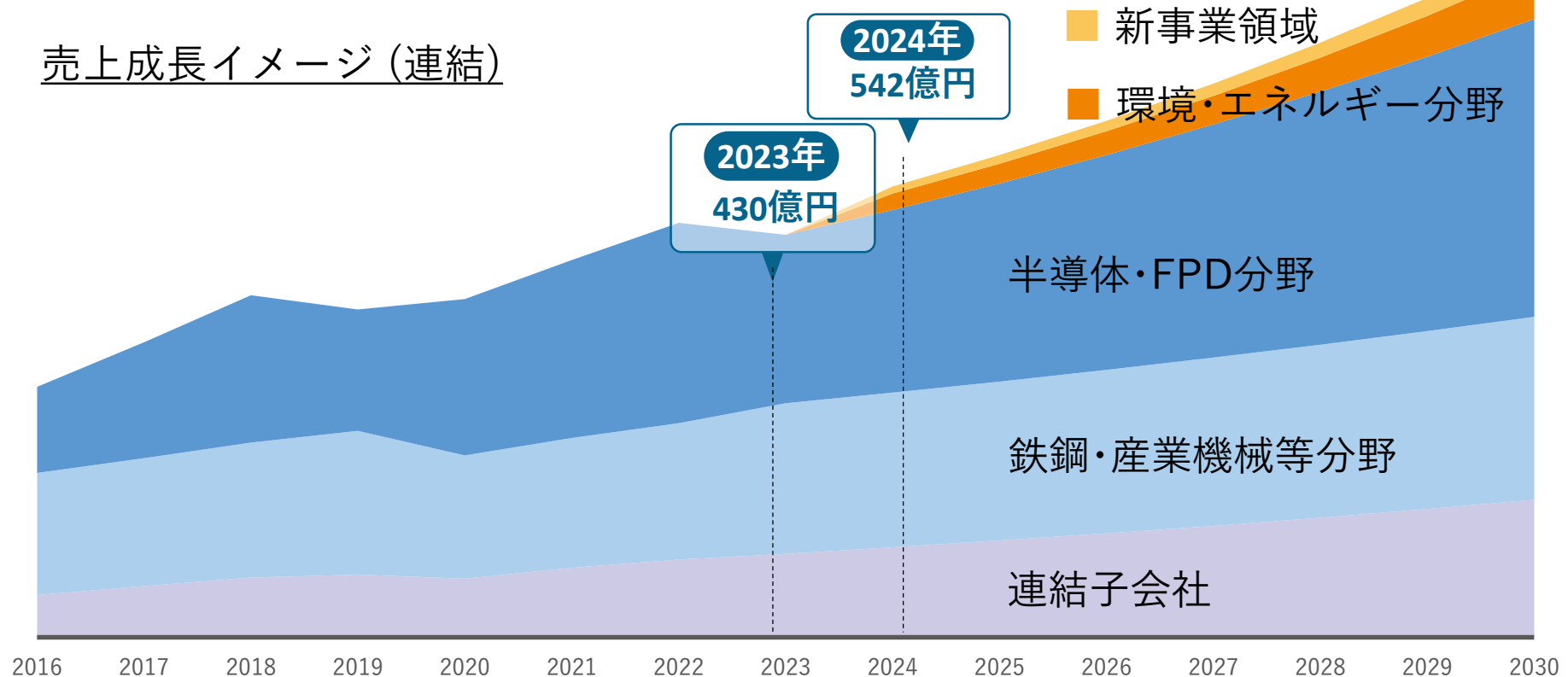
成長戦略

- 生産能力増強と自動化・省人化のための積極的な設備投資
- 半導体の微細化・多層化への対応をはじめ、新事業領域の開拓に向けた次世代皮膜開発

※検討中のイメージ

2030年
800億円～

売上成長イメージ（連結）



The background of the slide is decorated with numerous orange plus signs and four-pointed stars of varying sizes, some of which are blurred to create a sense of depth and movement.

ご清聴ありがとうございました。

(参考1) 経営指標ハイライト

(百万円)	2021/3期 実績	2022/3期 実績	2023/3期 実績	2024/3期 実績	2025/3期 実績	2026/3期 予想
受注高	39,021	45,394	48,419	47,505	56,159	—
受注残高	6,143	7,896	8,349	9,260	11,349	—
売上高	39,294	43,813	48,144	46,735	54,231	57,000
営業利益	8,890	10,255	10,558	9,197	12,271	13,000
経常利益	8,914	10,571	11,003	9,662	12,561	13,000
経常利益率	22.7%	24.1%	22.9%	20.7%	23.2%	22.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,463	6,909	7,350	6,326	8,052	8,330
1株当たり当期純利益 (EPS)	89.86円	113.62円	120.83円	105.53円	135.45円	140.11円
総資産	64,183	69,517	74,263	77,940	81,676	89,900
自己資本	44,201	49,099	53,839	55,460	60,646	64,700
自己資本比率	68.9%	70.6%	72.5%	71.2%	74.3%	72.0%
自己資本利益率 (ROE)	12.9%	14.8%	14.3%	11.6%	13.9%	13.3%
総資産経常利益率 (ROA)	14.2%	15.8%	15.3%	12.7%	15.7%	15.2%
投下資本利益率 (ROIC)	11.9%	13.0%	12.5%	10.2%	12.7%	12.6%

(注) ROE＝親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均自己資本、ROA＝経常利益÷期中平均総資産、ROIC＝税引後営業利益÷期中平均投下資本

売上高及び営業利益は、2022/3期の表示方法の変更（「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更）を反映した組替え後の数値です。

（参考 2）環境分野の受注推移

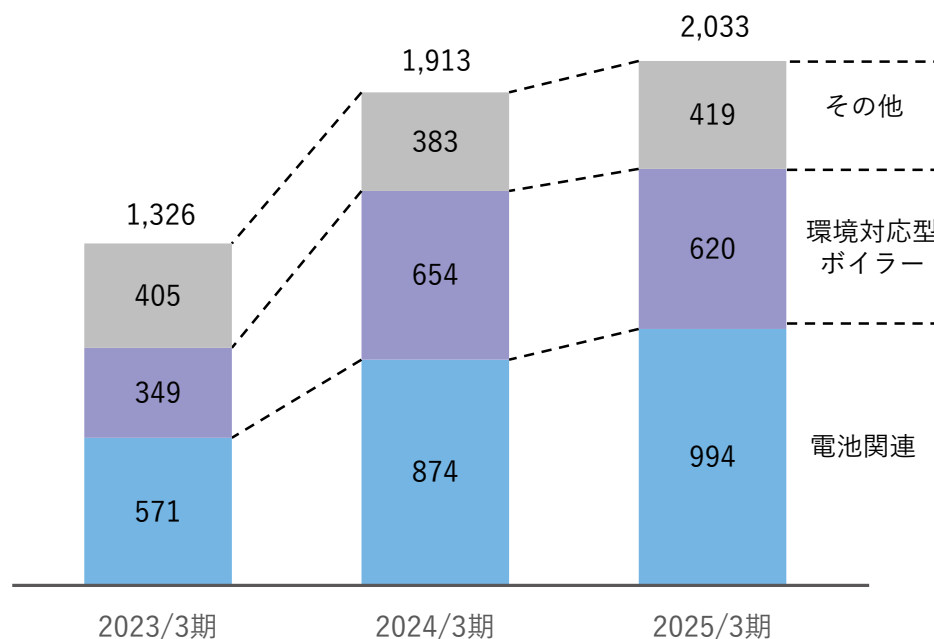
環境エネルギー機器



電池関連機器の加工が大きく伸長

受注高(百万円)

前期比
+4.7%



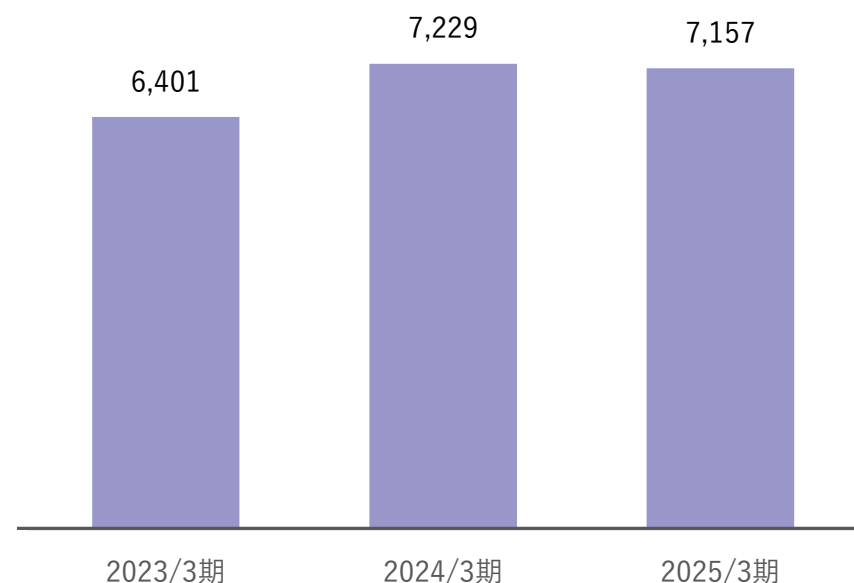
補修・再生品



顧客の設備部品等を補修・再生するための加工も堅調に推移

受注高(百万円)

前期比
-0.9%



注意事項

本資料における将来に関する記述は、発表日現在、当社が入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後のさまざまな要因により、実際の業績等はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

お問い合わせ先

トーカロ株式会社

経営企画部

TEL: 078-303-3433 (代)